

# 华为发布韬定律，长鑫科技IPO过会

## 半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年06月01日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

- 分析师：张璐
- SAC编号：S1050526010002
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

## 华为在ISCAS 2026发布"韬( $\tau$ )定律"，以"时间缩微"替代摩尔定律的"几何缩微"

5月25日，华为董事、半导体业务部总裁何庭波在2026国际电路与系统研讨会上发布半导体"韬( $\tau$ )定律"，核心是以"时间缩微"替代传统"几何缩微"——通过"逻辑折叠(Logic Folding)"等创新技术，系统性降低时间常数 $\tau$ ，在器件、电路、芯片到系统层面实现多层协同优化，驱动性能、能效与晶体管密度持续提升。何庭波透露，华为过去六年已基于该定律设计量产381款芯片，并预计到2031年，高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米等效水平。今年秋季推出的"麒麟2026"将首次实施逻辑折叠技术，由单层扩展至双层，实现晶体管密度等指标的大幅提升。这是中国首次在全球半导体领域提出指导产业发展的新原则，标志着国产芯片在先进制程受限背景下，通过系统级创新开辟"弯道超车"路径。

## 长鑫科技科创板IPO过会，国产DRAM龙头业绩大幅增长

5月27日，长鑫科技科创板IPO成功过会，拟募资295亿元用于存储器晶圆制造量产线升级、DRAM技术升级及前瞻研发。公司财务数据呈现爆发式增长：2025年营收617.99亿元，归母净利润18.75亿元实现扭亏；2026年Q1营收508亿元（同比+719%），净利润330.12亿元（同比+1268%），归母净利润247.62亿元（同比+1688%）。公司预计2026年上半年营收1100-1200亿元，归母净利润500-570亿元（同比+22倍至25倍）。股权结构分散，前三大股东为清辉集电（21.67%）、长鑫集成（11.71%）、大基金二期（8.73%）等，无单一股东持股超50%。作为国内DRAM规模第一、全球第四的存储龙头，长鑫科技此次IPO标志着国产存储替代进入资本加速阶段。

建议关注：中芯国际、拓荆科技、ASMPT、长电科技。

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

# 重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026/5/29 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
688981.SH	中芯国际	139.91	0.63	0.8	0.97	222.08	174.89	144.24	未评级
688072.SH	拓荆科技	627.99	3.28	5.55	8.56	191.46	113.15	73.36	买入
600584.SH	长电科技	82.05	0.87	1.08	1.37	94.31	75.97	59.89	买入
0522.HK	ASMPT	194	2.16	3.64	4.93	89.81	53.3	39.35	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期，港股股价和EPS货币单位为港元）

# 目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

# 01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

# 1.1、周涨幅排行

5月25日-5月29日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，环球晶圆领涨，涨幅为41.56%，格芯领跌，跌幅为6.62%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

证券代码	证券简称	国家/地区	市值(亿元)	PE(LYR)	PB(MRQ)	周涨跌幅(%)	
处理器	INTC.O	英特尔(INTEL)	美国	5760.38	-2157.44	5.17	-4.31
	QCOM.O	高通(QUALCOMM)	美国	2645.75	47.75	9.70	5.40
	AMD.O	超威半导体(AMD)	美国	8415.53	194.13	13.06	10.39
	NVDA.O	英伟达(NVIDIA)	美国	51095.88	42.56	26.14	-1.95
存储	MU.O	美光科技(MICRON TECHNOLOGY)	美国	10950.30	128.24	15.11	29.29
模拟	TXN.O	德州仪器(TEXAS INSTRUMENTS)	美国	2781.97	55.94	16.58	-1.14
	ADI.O	亚德诺(ANALOG)	美国	2015.81	88.91	5.97	4.23
	AVGO.O	博通(BROADCOM)	美国	21153.08	91.47	26.48	7.88
	NXP1.O	恩智浦半导体(NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	811.32	40.14	7.42	1.54
射频	SWKS.O	思佳讯(SKYWORKS)	美国	117.09	24.54	2.03	-4.72
	QRVO.O	QORVO	美国	91.15	26.89	2.73	-2.70
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	616.02	371.10	3.47	3.66
	ON.O	安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)	美国	472.71	390.67	6.47	3.80
光学	IFX.DF	英飞凌科技	德国	1053.75	103.82	6.05	10.47
	3008.TW	大立光	中国台湾	4597.56	21.61	2.49	-0.71
半导体设备	AMAT.O	应用材料(APPLIED MATERIAL)	美国	3573.29	51.06	14.95	4.14
	LRCX.O	拉姆研究(LAM RESEARCH)	美国	3979.07	74.26	37.59	4.20
	KLAC.O	科天半导体(KLA)	美国	2510.28	61.80	43.05	1.77
	ASML.O	阿斯麦	荷兰	6351.54	56.41	26.46	-1.23
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	4852.85	66.37	5.20	41.56
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	685326.05	35.97	10.37	4.43
	GFS.O	格芯(GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	438.57	49.56	3.75	-6.62
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	2234.17	131.90	5.46	-0.75
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	854.02	66.18	7.81	10.17
分销	ARW.N	艾睿电子(ARROW ELECTRONICS)	美国	109.75	19.21	1.63	-1.24
	AVT.O	安富利(AVNET)	美国	71.30	29.68	1.44	1.19

资料来源：wind，华鑫证券研究

## 1.2、申万一级行业估值水平

5月25日-5月29日当周，申万半导体指数整体呈现下跌的态势。5月29日，申万半导体指数为10480.14，周跌幅为1.48%。

图表3：2000-2026年申万半导体指数

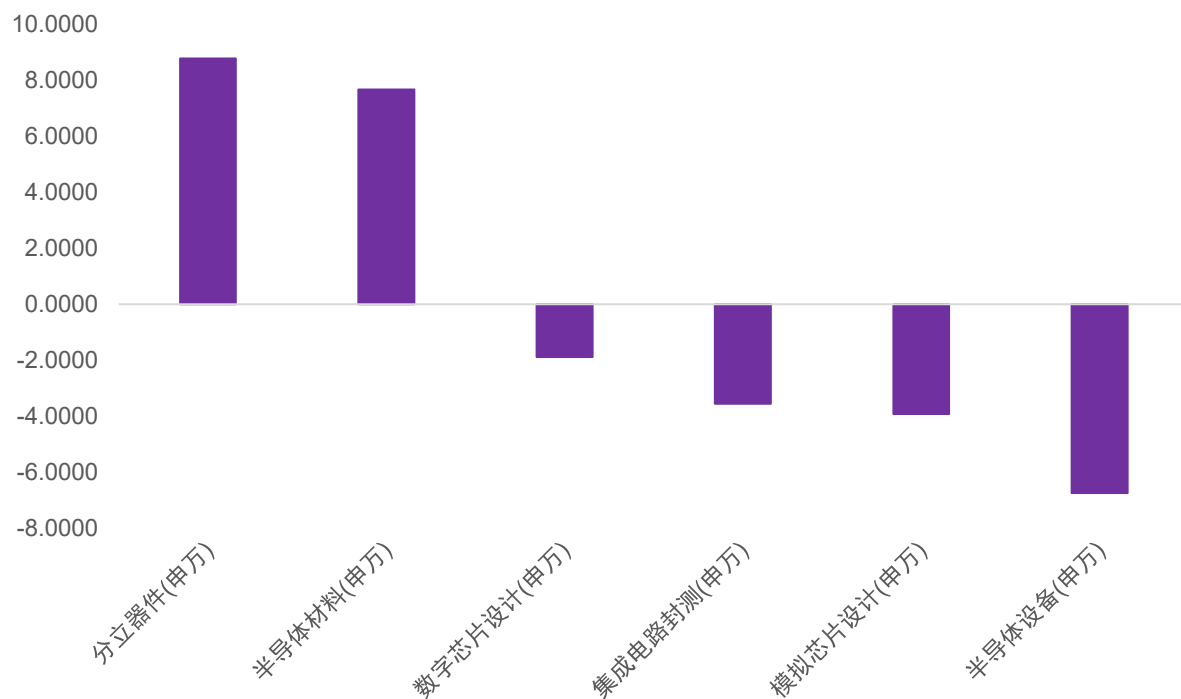


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

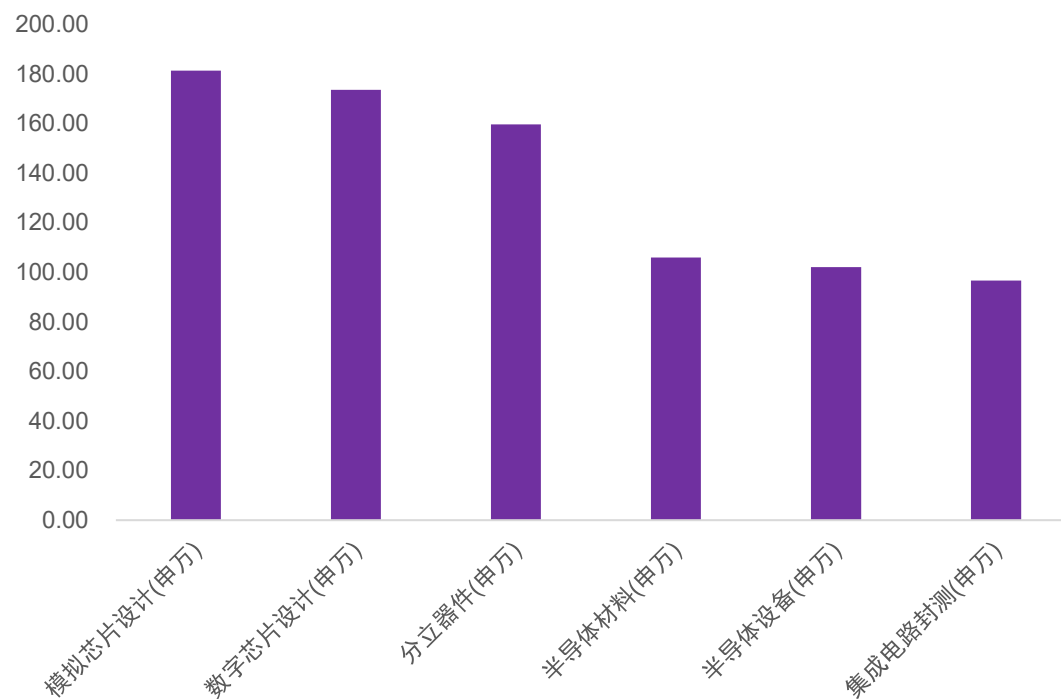
# 1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，5月25日-5月29日当周，半导体细分板块呈分化态势。其中，分立器件板块涨幅最大，达到8.77%；半导体设备板块跌幅最大，达到6.74%。估值方面，模拟芯片设计、数字芯片设计、分立器件板块估值水平位列前三。

图表4：5月25日-5月29日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：5月29日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

## 1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：

通信设备板块主力净流入45.07亿元，主力净流入率为0.42%，在9个二级子行业中排第1名，也是唯一实现净流入的板块；半导体板块主力净流出367.04亿元，主力净流出率为-1.43%，在9个子行业中排第3名；计算机设备板块主力净流出94.67亿元，主力净流出率为-4.69%，在9个子行业中排第9名

图表6：5月25日-5月29日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW通信设备	55,537,538.14	55,086,832.60	450,705.54	0.42	-1
SW电子化学品II	10,643,178.84	10,998,894.88	-355,716.03	-1.30	-1
SW半导体	119,107,310.19	122,777,742.34	-3,670,432.16	-1.43	4 -
SW其他电源设备II	5,139,960.99	5,385,349.20	-245,388.20	-1.75	-4
SW其他电子II	6,716,899.31	7,064,537.09	-347,637.78	-1.96	-1
SW消费电子	29,555,372.34	30,948,521.31	-1,393,148.97	-2.03	-4
SW军工电子II	6,652,679.65	7,142,932.98	-490,253.33	-2.44	-1
SW航天装备II	1,251,723.29	1,405,669.06	-153,945.77	-3.10	-5
SW计算机设备	6,407,359.93	7,354,096.05	-946,736.12	-4.69	-5

资料来源：wind，华鑫证券研究

## 1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

5月25日-5月29日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：锆威特，风华高科，沃格光电，\*ST闻泰，晶升股份，盛科通信，天孚通信，东微半导，汇成股份，华海诚科，周涨幅分别为：43.79%，40.96%，30.10%，27.59%，24.20%，22.57%，22.20%，18.71%，17.52%，16.69%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值 (亿元)	EPS			PE			PB	周涨跌幅 (%)
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
688693. SH	锆威特	59.77	-1.32	-	-	-61.48	-	-	7.52	43.79
000636. SZ	风华高科	613.56	0.24	0.53	0.65	215.03	100.20	81.52	4.92	40.96
603773. SH	沃格光电	233.91	-0.71	1.45	0.68	-172.22	72.42	153.89	22.15	30.10
600745. SH	*ST闻泰	257.27	-7.03	2.49	-	-2.94	8.32	-	1.13	27.59
688478. SH	晶升股份	49.65	0.39	-	-	92.37	-	-	3.29	24.20
688702. SH	盛科通信-U	873.30	-0.17	-0.06	0.13	-1279.28	-3493.20	1617.22	39.13	22.57
300394. SZ	天孚通信	3546.74	2.59	4.18	5.53	175.78	109.13	82.46	58.99	22.20
688261. SH	东微半导	114.64	0.38	1.08	1.75	339.11	86.35	53.21	3.89	18.71
688403. SH	汇成股份	151.77	0.19	0.33	0.30	95.00	55.19	54.82	3.80	17.52
688535. SH	华海诚科	115.22	0.50	-	1.09	288.51	-	110.47	5.39	16.69

资料来源：wind，华鑫证券研究

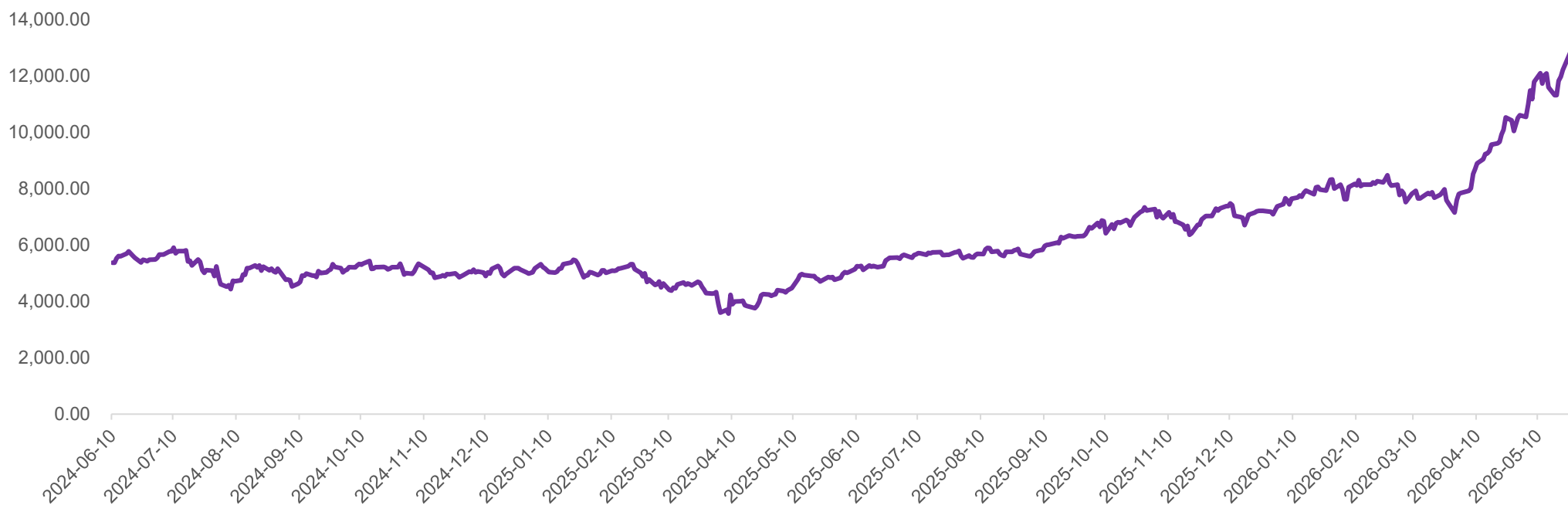
# 02 行业高频数据

研究创造价值

## 2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，5月25日-5月29日当周，费城半导体指数总体呈现震荡上升的态势，续创历史新高。从更长的时间维度上来看，2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。2026年一季度延续上涨态势，3月初出现短暂大幅回调后迅速反弹，二季度以来加速上行，不断刷新历史高点。

图表8：费城半导体指数近两年走势

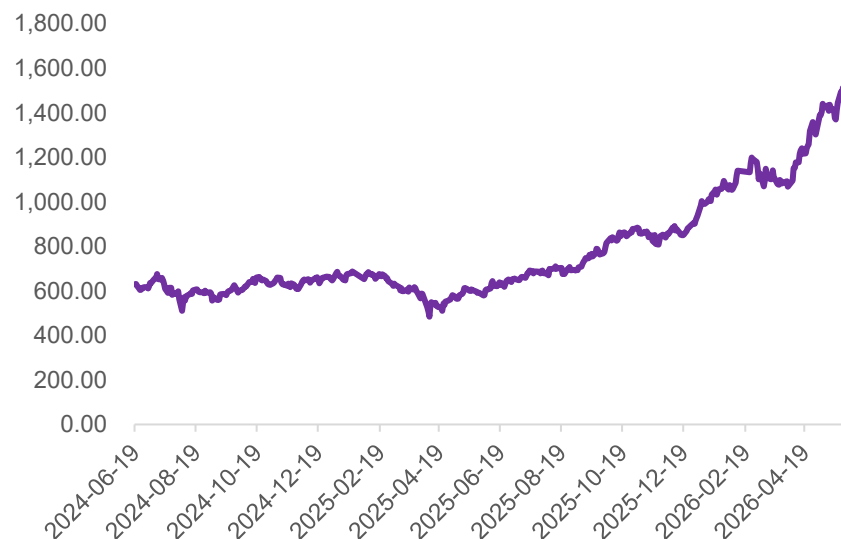


资料来源：wind，华鑫证券研究

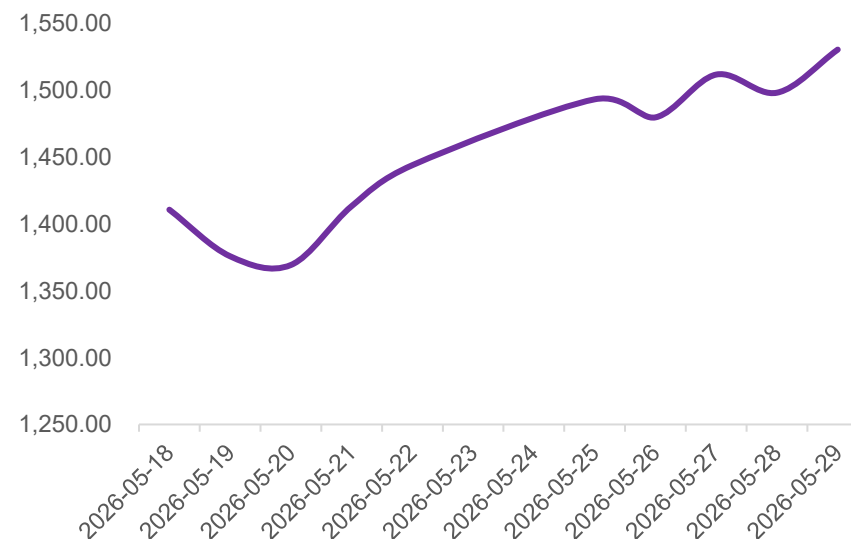
## 2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，5月18日-5月29日两周，台湾半导体行业指数呈现先抑后扬、持续上行的态势，续创历史新高。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，三季度进入震荡行情，四季度探底。2025年一季度触底回升，随后进入持续上行的趋势。2026年以来加速上涨，不断刷新历史高点。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势

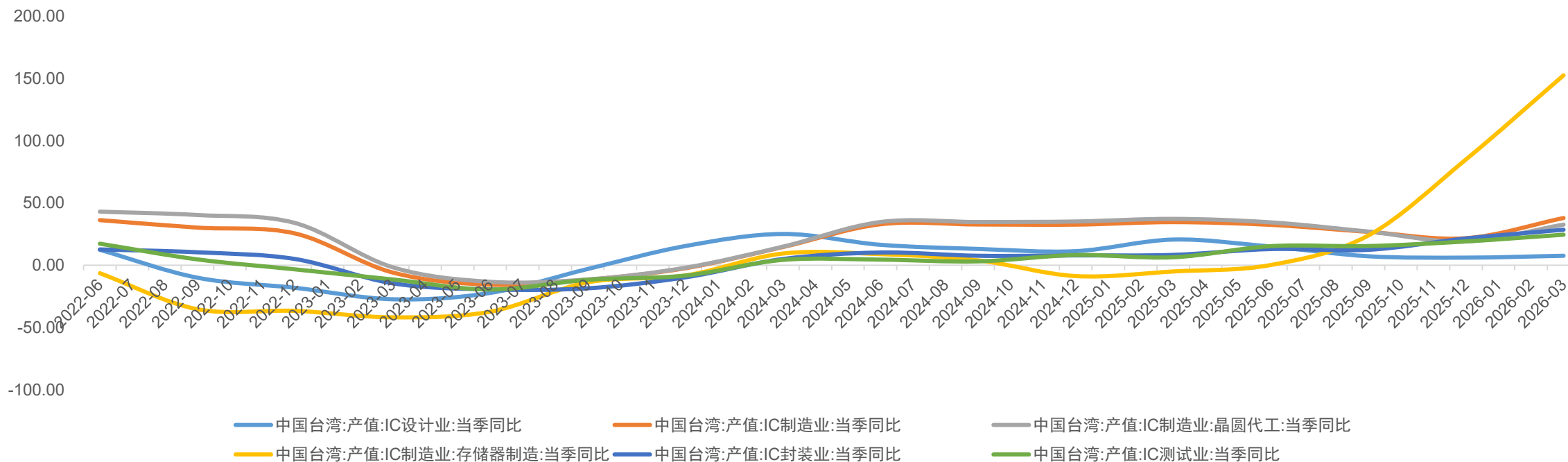


资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹。此前IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求疲软导致IC设计下滑，叠加2021年缺货涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速维持正增长；IC封装、测试业产增速维持平稳；中国台湾存储器制造业下半年以来产值同比大幅提升。2026年一季度，存储器制造业产值同比继续提升，各板块均保持正增长态势。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

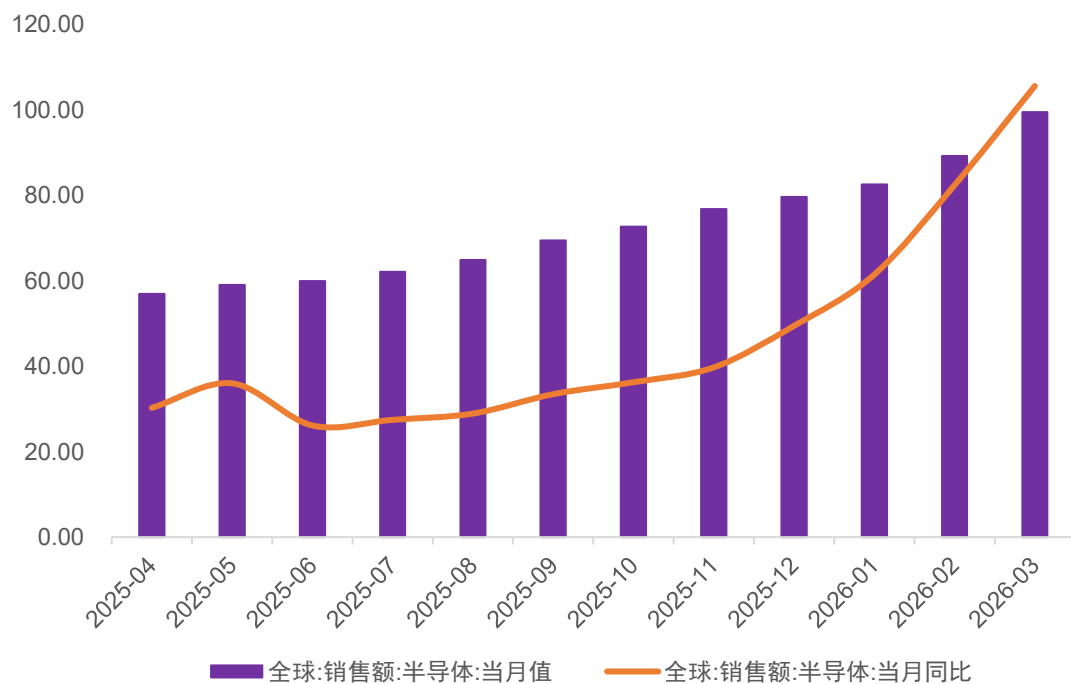


资料来源：wind，华鑫证券研究

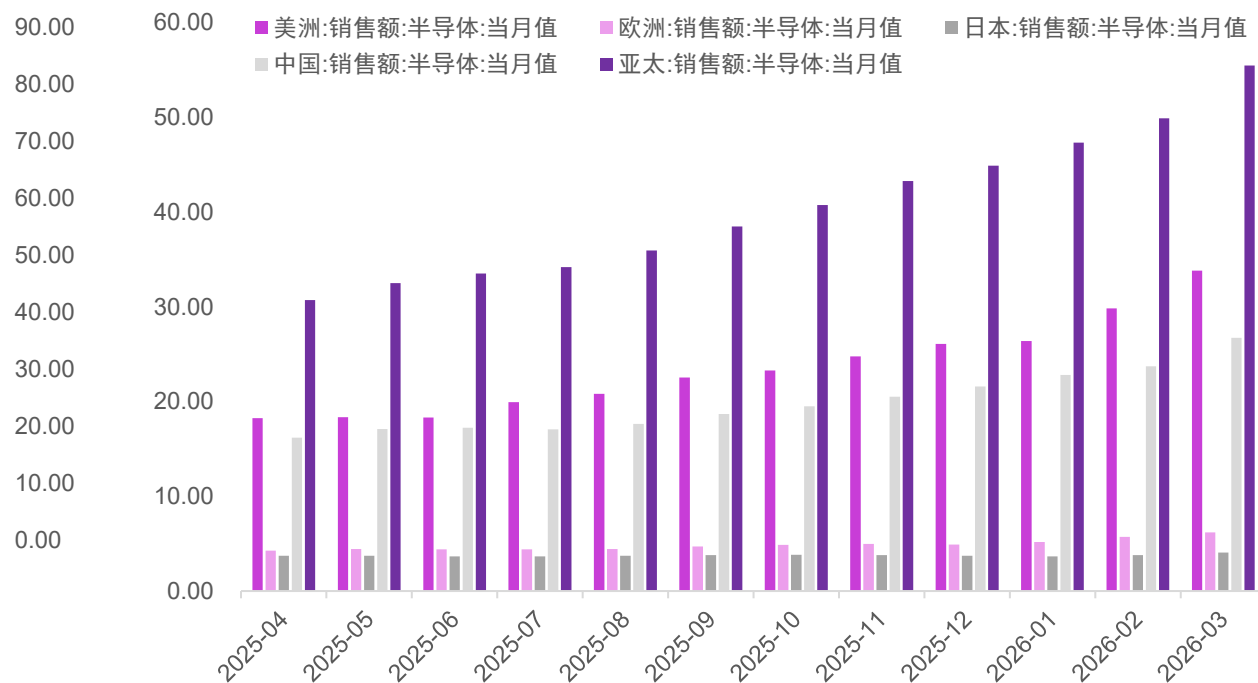
## 2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年3月，全球半导体当月销售额为995.2亿美元，同比增长79.20%。其中，中国销售额为267.4亿美元，环比增长12.68%，占比达26.87%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



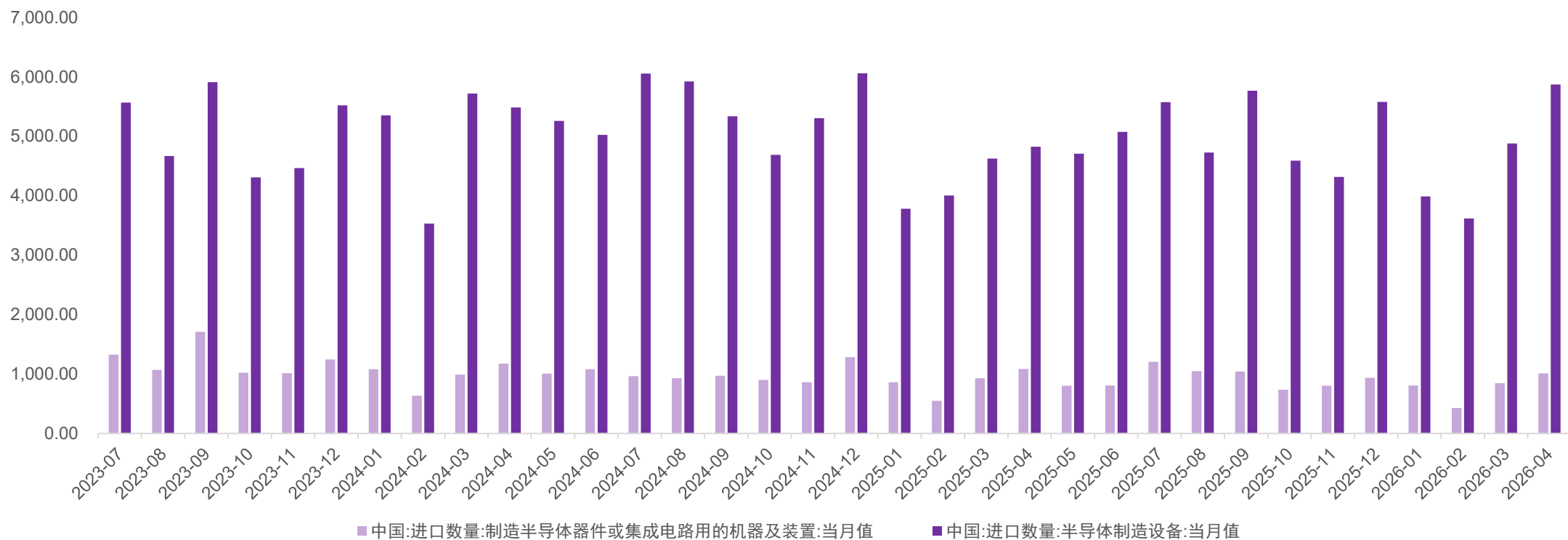
资料来源：wind，华鑫证券研究



## 2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。2026年以来，半导体制造设备进口数量维持高位运行，4月当月进口量接近6000台。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

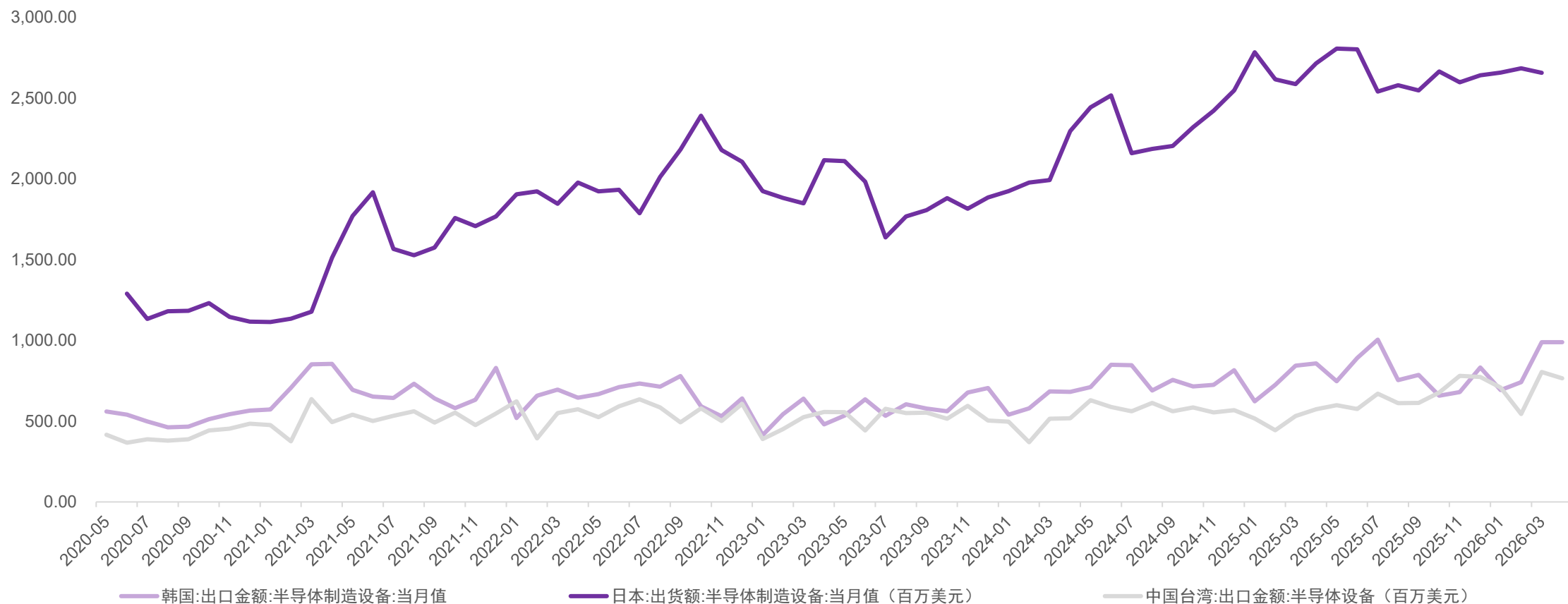


资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势，2024年以来在高位震荡。韩国和中国台湾半导体设备出口额2025年下半年以来震荡上升。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

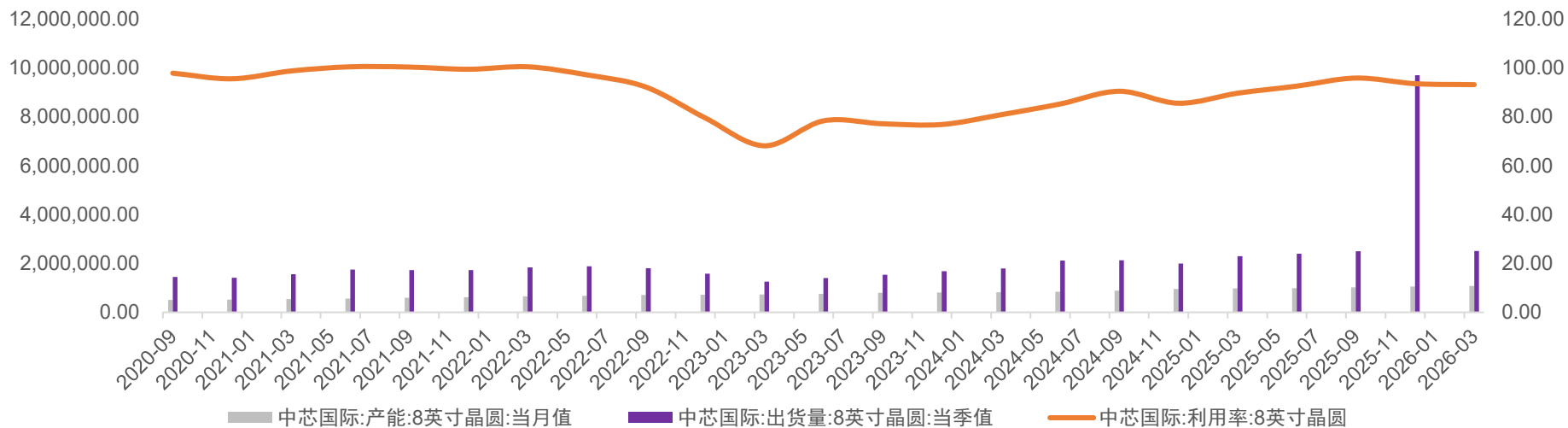
## 2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2026年一季度，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约93.1万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，2026年一季度维持95%左右的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2026年以来维持高位运行，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

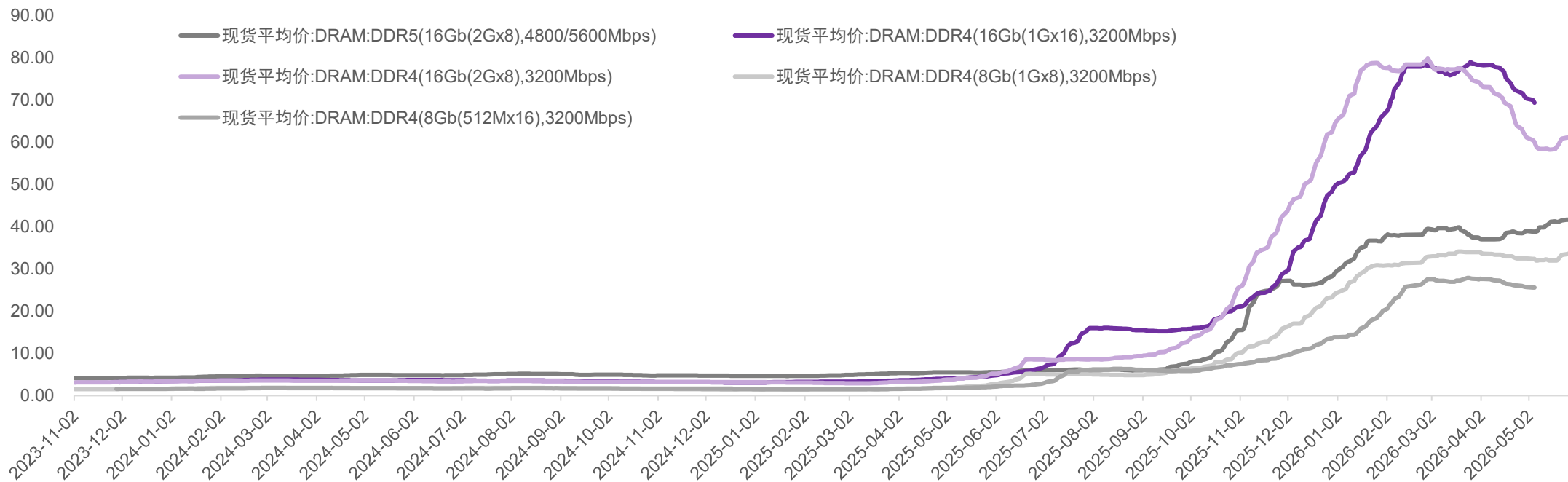


资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年5月18日价格为20.71美元。DRAM方面：DDR5现货均价2026年3月以来稳中有升，5月底价格为41.90美元；DDR4各型号现货均价2026年以来从高位回落，其中16Gb(2Gx8)型号5月底价格为61.95美元，较年初高点明显回调。

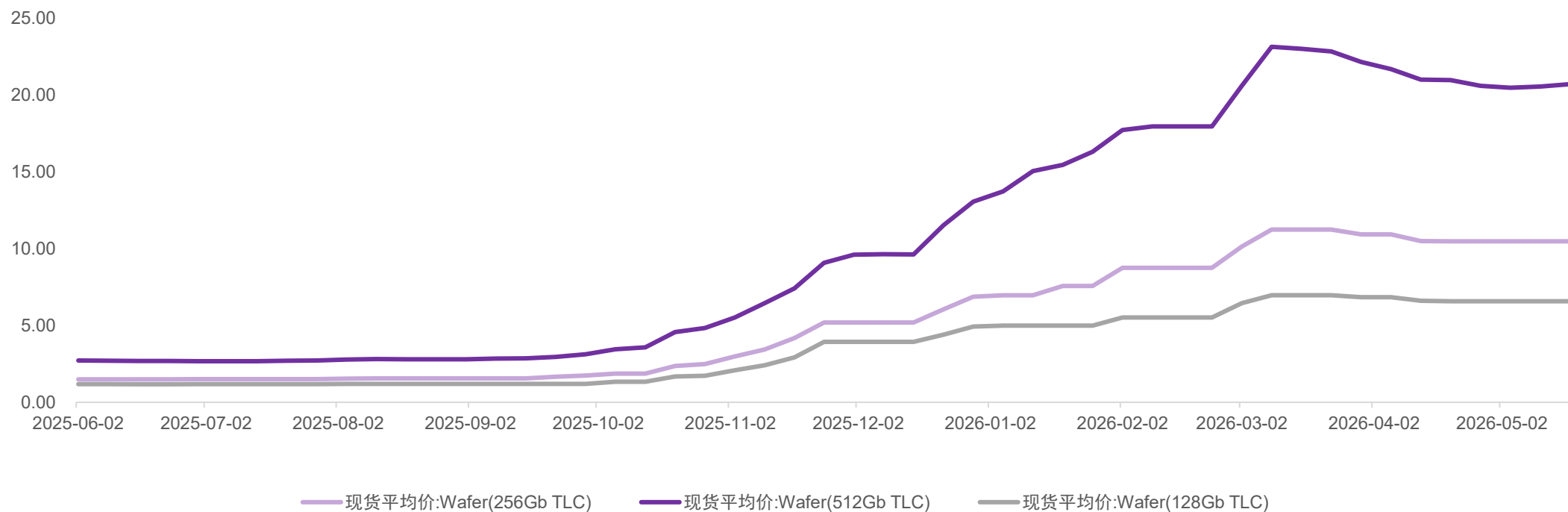
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

## 2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

# 03 行业动态

研究创造价值

### ■ 华为发布半导体“ $\tau$ 定律”，提出“时间缩微”替代“几何缩微”新路径

5月25日，2026国际电路与系统研讨会在上海举行。华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表了半导体领域新定律——“ $\tau$ 定律”。

据介绍，“ $\tau$ 定律”首次提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，晶体管密度与系统性能通过逻辑折叠技术实现新突破。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。这也是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。此次，华为创新性地提出了“逻辑折叠(LogicFolding)”等核心技术，构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层次协同优化体系。该体系以系统性降低时间常数 $\tau$ 为目标，旨在驱动各层级性能、能效、晶体管密度的持续提升。

何庭波说，2020年后，与合作伙伴一起，华为付出了巨大努力使手机芯片重回市场。2025年推出麒麟9030Pro后，华为手机芯片进入性能“饱和区”。为此，华为基于以“时间缩微”替代“几何缩微”的新定律，找到了新的路径，使手机芯片性能实现阶跃式提升。

基于该定律，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。何庭波预计，到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。对于即将于今年秋季推出的“麒麟2026”手机芯片，何庭波表示，该芯片是逻辑折叠技术的首次成功实施，性能大幅提升。它基于全新的自由逻辑设计理念，由单层扩展至了双层，并实现晶体管密度等指标的大幅提升。“我们取得了一系列仅靠先进制程工艺难以取得的进步。”何庭波说，诸如此类的大量创新，会逐步落地到2027年及之后的量产芯片中。

### 长鑫科技IPO过会，市值有望冲击3万亿

2026年5月27日，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）科创板IPO成功过会。上交所上市审核委员会认为，长鑫科技符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据最新披露的IPO招股书显示，长鑫科技科创板IPO拟募集资金高达295亿元，主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目。

最新财务资料显示，长鑫科技2022年、2023年、2024年和2025年营收分别为82.87亿元、90.87亿元、154.38亿元、617.99亿元；归母净利润分别为-83.28亿元、-163.40亿元、-71.45亿元和18.75亿元。长鑫科技2026年一季度营收为508.00亿元，同比暴涨13%，环比（2025Q4营收为297.15亿元）70.96%；净利润为330.12亿元，同比增长1268.45%；归母净利润为247.62亿元，同比暴涨1688.30%；扣非净利润为263.41亿元，同比暴涨1993.41%。

长鑫科技还披露了2026年1-6月的业绩预计情况：预计营收介于1100亿元至1200亿元，同比暴涨612.53%至677.31%；净利润为660亿元至750亿元，同比暴涨1714.67%至1934.85%；归母净利润将介于500亿元至570亿元，同比暴涨2244.03%至2544.19%；扣非净利润为520亿元至580亿元，同比暴涨2278.89%至2530.30%。

根据招股书披露，长鑫科技目前无单一股东持股超过50%，前五大持股5%以上的股东分别为清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫及安徽省投，持股比例依次为21.67%、11.71%、8.73%、8.37%和7.91%。

### 紫光国微拟收购瑞能半导体

紫光国微（002049）于5月22日发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，收购瑞能半导体科技股份有限公司100%股权，交易对价为19亿元。同时，公司计划募集配套资金不超过3.96亿元，用于支持本次交易相关支出及后续发展。

此举被公司视为“打造半导体全产业链布局的重要战略举措”。紫光国微现有业务已涵盖特种集成电路、智能安全芯片及石英晶体频率器件等领域，在功率半导体细分领域也具备一定技术储备与市场基础。而通过此次收购，公司将有望快速补齐功率半导体制造环节，整合产品矩阵，进一步完善全产业链布局，巩固行业优势地位。

公开资料显示，瑞能半导体是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装设计及模块封装测试一体化经营能力的功率半导体企业。其主要产品包括晶闸管、功率二极管、碳化硅二极管等，广泛应用于消费电子、工业制造、新能源及汽车等领域，并已在部分产品上形成较为突出的市场地位。

值得一提的是，瑞能在第三代半导体——碳化硅领域已有成熟的技术积累和客户资源。当前，以碳化硅为代表的第三代半导体正成为全球功率半导体行业的重要增长极，被视为国内企业实现“弯道超车”的核心赛道。行业正从技术研发向规模化量产过渡，时间窗口至关重要。

紫光国微指出，通过本次交易，公司将获得瑞能成熟的碳化硅技术与客户资源，大幅缩减工艺验证与产品认证周期，加速高端功率器件的研发与生产。同时，整合双方技术、市场资源，将进一步增强公司在半导体产业的综合竞争力。

从行业背景看，功率半导体市场需求正持续扩张。受益于新能源汽车、光伏储能、AI数据中心、工业控制等下游领域快速渗透与技术升级，Omdia数据显示，2023年全球功率半导体市场规模已达503亿美元，预计2027年将增长至596亿美元。中国作为全球最大功率半导体消费国，市场前景广阔。

### ■ 时隔两个月，意法半导体再度涨价

5月28日，MCU及功率半导体大厂意法半导体（STMicroelectronics）向客户发出了“价格调整通知函”，宣布将自2026年6月28日起对部分产品价格进行上调。这是意法半导体在今年3月24日宣布将多个产品线价格自4月26日起进行上调之后，今年以来的第二度宣布涨价。显然，仅时隔仅两个月，意法半导体再度宣布调价，凸显出成本端压力的持续加剧。意法半导体在最新的涨价函中表示，“今年早些时候，我们对部分产品进行了价格调整。作为对运营成本和供应成本大幅上升的应对措施。但从那以后，通货膨胀的压力持续存在，同时原材料价格也进一步上涨。不幸的是，我们整个行业在运输和人力成本方面都面临着巨大的负担。需要进行额外的调整，这些调整主要针对那些在之前的调整中未被涵盖的产品。”

值得一提的是，在此之前，英飞凌、德州仪器等国际功率半导体巨头也纷纷发布涨价通知，行业涨价潮正全面蔓延。英飞凌于5月26日通知客户及合作伙伴，将自7月1日起调整部分产品价格，这是继2026年4月首轮提价之后，英飞凌年内的第二次价格上调。德州仪器（TI）此前也宣布确计划自2026年7月1日起上调电源管理IC等核心产品报价，这是该公司一年内第四次价格调整。电源管理芯片大厂MPS今年3月也发出涨价函，宣布5月1日起对部分产品调价。最新消息显示，MPS还计划在7月进一步扩大调价范围、提升涨幅。

### 中国首款，比亚迪发布4nm智驾芯片

5月28日晚间，在比亚迪智能化战略发布会上，比亚迪集团董事长兼总裁王传福正式发布中国首款4nm车规级智驾芯片——“璇玑A3”，3颗算力超过2100 TOPS，支持L3/L4自动驾驶。这标志着比亚迪在智能汽车核心芯片领域实现了重大突破。

据介绍，璇玑A3是比亚迪自主研发的高算力智能驾驶芯片，采用车规级4纳米制程工艺，拥有16核CPU架构，主频高达2.5GHz，DMIPS算力达420K，带宽达到273GB/s，最高功能安全等级为ASIL-D。在算力组合配置上，单车搭载三颗该芯片即可实现超过2100 TOPS的综合算力，全面支持L3及L4级别自动驾驶系统的运行。

王传福在发布会上特别强调了车规级芯片的研发难度：“4nm车规级智驾芯片相当于消费级芯片的2nm，难度很大。”他表示，车规级4nm芯片需要经受极端温度考验、通过多项安全认证，并保证稳定工作十年以上，其难度远超消费级4nm芯片。

与行业同级别产品相比，璇玑A3在多个维度实现了突破。单位算力功耗达到业内最低水平，较同级产品降低20%。结合比亚迪自研算法优化，算力利用率提升100%。单车搭载三颗芯片可实现超过2100 TOPS的综合算力。

## 3.6、行业动态整理

### 英飞凌宣布涨价，7月1日生效

根据最新曝光的内部资料示，MCU及功率芯片大厂英飞凌于2026年5月26日向客户发出通知，宣布计划对旗下部分产品实施价格调整，调整将于2026年7月1日生效。英飞凌表示，由于地缘政治紧张局势的影响，当前全球半导体行业持续面临巨大的成本压力。这正导致英飞凌整个供应链中来自能源、原材料、运输及服务等领域各项成本不断攀升。与此同时，英飞凌产品组合内的需求正急剧增长，且范围远超出数月前预期的水平。为维持对客户的可靠供应与服务，英飞凌正在进一步大幅加快投资步伐，以扩大其产能。尽管英飞凌一直在努力应对这些影响，但自身已无法再通过内部途径来消化它们。不过，英飞凌并未透露，此次涨价所涉及的具体产品线和涨价幅度。猜测有可能涵盖了面向数据中心的功率器件。

值得注意的是，在今年2月，英飞凌就曾发出涨价通知称，由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧，以及原材料与基础设施成本攀升，公司将自2026年4月1日起对这部分产品价格进行上调。在今年5月初的2026财年第二季度财报（截至2026年3月31日）财报会议上，英飞凌就指出，凭借AI数据中心电源解决方案的强劲需求以及汽车业务订单回暖，公司不仅达成上半年目标，更全面上调了全年业绩指引——由此前指引的“中等温和增长”转为“显著增长”。

英飞凌CEO Jochen Hanebeck表示：“AI热潮持续增强，我们面向AI数据中心的电源解决方案需求极为旺盛。”其中，AI数据中心应用收入以及在当前财年将达到约15亿欧元，下一财年进一步提升至约25亿欧元。

### 三星成功开发出900层NAND原型

5月25日消息，据韩国媒体news报道，存储芯片巨头三星电子近日成功开发出全球首个900层级V-NAND原型技术，向着“1000层NAND”的终极目标迈出了实质性的一步。在与竞争对手的激烈角逐中，这将成为三星一项极具分量的技术筹码。

此次突破的核心，是一种名为“单元多键合（CMB）”的技术。简单来说，三星将两片各450层的晶圆像“三明治”一样精准连接，合二为一，打造出900层级的集成系统。堆叠更多NAND层，意味着能在更小的芯片空间内塞进更大的存储容量，同时还能降低功耗。对于AI计算这类极度渴求数据吞吐量的工作负载，这种高密度堆叠结构的优势正日益凸显。

目前，SK海力士在量产市场以321层4D NAND保持领先，并创下了业内最高良率。而三星今年正准备量产第十代V-NAND（V10，超过400层），如今又在研发阶段迅速突破900层，已在下一代NAND的竞赛中抢占了一个有利身位。三星强调，这项研究“验证了电池正常工作特性”，意味着它已超越理论推演，达到了可实际操作阶段。

### 美光市值突破1万亿美元

美东时间5月26日，美国存储芯片巨头美光科技股价单日暴涨逾19%，总市值一举突破1万亿美元大关，正式成为全球极少数跻身“万亿美元市值俱乐部”的半导体企业之一。从当日市场行情来看，美光科技当日股价最高触及916.8美元，最终收报895.88美元，涨幅高达19.3%，创下自2011年以来的最大单日涨幅纪录。这一涨势使得美光市值达到约1.01万亿至1.023万亿美元，不仅超越了礼来和沃尔玛，成为美国市值第十大上市公司，也标志着存储芯片行业在AI时代的价值重估达到了新高度。

此次美国股价大涨的直接催化剂来自瑞银发布的一份极具震撼力的研报。瑞银分析师蒂莫西·阿库里将美光科技的目标价从535美元大幅上调至1625美元，上调幅度超过三倍，这也是目前华尔街给予该股的最高目标价。若按此目标价测算，美光未来的市值有望冲击1.8万亿美元，甚至可能超过特斯拉和Meta等科技巨头。

值得一提的是，当地时间5月22日，美光科技公司庆祝其位于弗吉尼亚州马纳萨斯的晶圆厂开始生产1 $\alpha$  (1-alpha) DRAM芯片，这是该公司大幅扩展美国内存制造的重要一步，将使其在美国的DDR4晶圆供应量直接翻上4倍，以解汽车、国防、航空航天等关键工业的“燃眉之急”。

在市场竞争方面，三星电子与SK海力士同样正运用各自的1c DRAM制程积极开发HBM4E。三星计划于2026年第二季出货首批HBM4E样品，其基础晶片将采用三星自家晶圆代工厂的4nm制程制造。SK海力士则目标在2026年下半年向客户提供样品，并于2027年展开量产，其基础芯粒据传也将采用台积电的3nm制程生产。

### Anthropic融资650亿：三大存储巨头入股，估值9650亿

当地时间5月28日，由OpenAI前核心成员创立的AI安全研究与产品公司Anthropic正式宣布，已完成650亿美元的H轮融资，投后估值达到9650亿美元（约合人民币6.5万亿元）。这一估值首次超越竞争对手OpenAI，后者在今年3月融资后的估值为8520亿美元。Anthropic距离万亿俱乐部仅一步之遥。

值得注意的是，本轮融资中包含来自多家超大规模云服务商此前已承诺的150亿美元投资，其中亚马逊一家就贡献了50亿美元。亚马逊曾在4月份表示将向Anthropic投资至多250亿美元，作为交换，这家AI初创公司承诺未来10年内在亚马逊云技术上支出超过1000亿美元。本轮融资一个引人注目的亮点是，全球三大存储芯片巨头——三星电子、SK海力士和美光科技——首次同时作为“战略基础设施合作伙伴”加入投资。

值得注意的是，Anthropic公司在今年2月完成G轮融资时，估值为3800亿美元。短短约三个半月内，估值暴增5850亿美元，增幅高达约154%。与之形成对比的是，OpenAI在3月完成最新一轮融资后估值也仅为8520亿美元。这意味着Anthropic目前领先OpenAI约1130亿美元，领先幅度超过13%。

伴随融资公告，Anthropic近期还披露了大规模算力扩张计划。近期，Anthropic与亚马逊签署了高达5吉瓦新增容量的协议，与谷歌和博通签署了5吉瓦下一代TPU容量协议，并与SpaceX签署了获取其Colossus 1和Colossus 2数据中心GPU容量的协议。Claude也是首个在全球三大云平台——亚马逊云科技、谷歌云和微软Azure——上均可用的前沿模型。

# 04 公 司 公 告

研究创造价值

### 中微公司:2025年年度权益分派实施公告

根据中微公司（688012）发布的2025年年度权益分派实施公告，本次2025年年度利润分配及转增股本方案的分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

本次分配以方案实施前的公司总股本628,840,931股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计派发现金红利220,094,325.85元，转增308,132,056股，本次分配后总股本为936,972,987股。

### 长川科技:杭州长川科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

根据杭州长川科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告，~~2025~~2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。自上述权益分派方案披露至实施期间，因公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份上市，合计上市16,000股，公司总股本由634,402,614股增加为634,418,614股；因公司股本总额发生变动，根据本次权益分派实施方案，维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额后，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币63,441,861.40元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致，且距离股东会通过的时间未超过两个月。扣税方面，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。

### 豪威集团:2025年年度权益分派实施公告

根据豪威集团2025年年度权益分派实施公告，本次利润分配方案经公司2026年5月7日的2025年年度股东会审议通过。根据差异化分红方案，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至2026年5月27日，公司总股本为1,261,329,399股（其中A股总股本为1,210,588,299股，H股总股本为50,741,100股），扣除公司回购专用账户上已回购A股股份6,002,763股，本次实际参与分配的股本总数为1,255,326,636股。按此计算，本次共计派发现金红利总额为人民币125,532,663.60元（含税），其中，拟向A股股东派发现金红利为人民币120,458,553.60元（含税）。

### 江波龙:2025年度、2026年第一次中期权益分派实施公告

根据江波龙2025年度、2026年第一次中期权益分派实施公告，公司2025年度、2026年第一次中期权益分配方案为：以公司现有总股本423,061,007股为基数，向全体股东每10股派9.907442元人民币现金（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派8.916698元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.981488元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.990744元；持股超过1年的，不需补缴税款。

本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。按照中国结算深圳分公司要求，实际分派现金红利时，“分”以下金额，即小于0.01元的金额，作舍尾处理。

### 拓荆科技:2025年年度权益分派实施公告

根据拓荆科技2025年年度权益分派实施公告，公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

截至本公告披露日，公司总股本为282,693,012股，以扣除回购专用证券账户中的1,267,894股后的281,425,118股为基数，以此计算拟合计派发现金红利92,870,288.94元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 南芯科技:2025年年度权益分派实施公告

根据南芯科技2025年年度权益分派实施公告，公司以权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专户股数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。公司2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

截至本公告披露日，公司总股本为427,663,170股，扣除回购专户股数1,752,889股后剩余可参与本次利润分配的股份数为425,910,281股，共计派发现金红利总额为106,477,570.25元（含税）。

根据公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

### 雅克科技:2025年年度权益分派实施公告

根据雅克科技2025年年度权益分派实施公告，公司本次利润分配方案的具体内容为：以最新总股本475,927,678.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.10元（含税），共计147,537,580.18元。不进行资本公积转增股本。在利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。

本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本475,927,678股为基数，向全体股东每10股派3.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.790000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

# 05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

## 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

## 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

**相关证券市场代表性指数说明：**A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券

CHINA FORTUNE SECURITIES

研 究 创 造 价 值